SBH 分流插件电阻器

产品特点

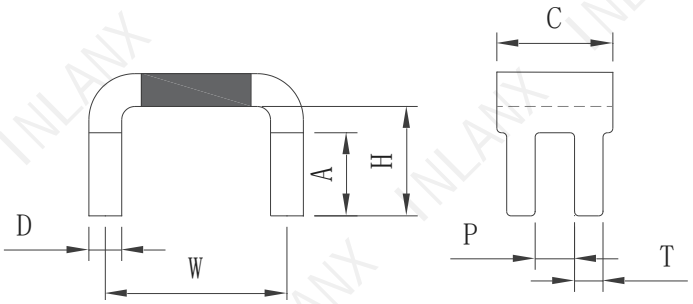
- 精度：±5%、±2%、±1%、±0.5%
- 使用温度：-65℃~170℃
- 电子束焊接；适用于脉冲应用
- 符合RoHS要求；特殊规格可订做



应用范围

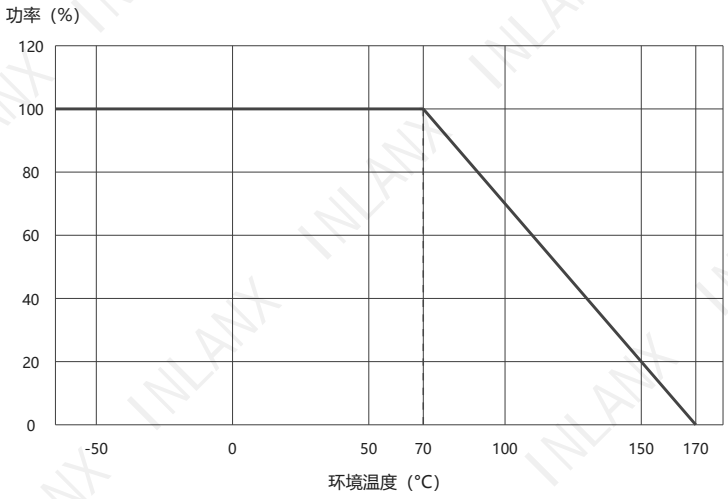
变频及伺服驱动；大电流电池管理系统；汽车电子控制及油泵驱动；DC/DC、DC/AC电源模块；自动化控制；工业仪器设备。

产品尺寸 • mm



型号	W （mm）	H （mm）	T （mm）	C （mm）	A （mm）	P （mm）
SBH	8.3±0.3	5±1	1.3±0.2	5.3±0.3	3.8±0.5	1.8±0.2

降功率曲线



技术参数

型号	合金材料	阻值 （mΩ）	D±0.1 (mm)	TCR (ppm/℃)	P70 °C （W）
SBH	M	0.25	1.5	±100	5
SBH	M	0.3	1.34	±100	3
SBH	M	0.4	1.04	±100	3
SBH	M	0.5	0.83	±100	3
SBH	M	0.7	0.59	±100	3
SBH	M	1	0.45	±100	3
SBH	K	1	1.16	±50	5
SBH	K	2	0.63	±50	4
SBH	K	3	0.43	±50	3

TCR测试温度：20℃~120℃；D±0.1mm与尺寸图中的D对应。

耐久性试验

试验项目	试验条件	依据	变化限值
温度循环	1000次循环；(-55℃ to +125℃)	JESD22 Method JA- 104	±0.5%
高温暴露	170℃，100h，不通电。	MIL-STD-202 Method 108	±0.5%
偏置湿热	85℃ / 85%RH，1000h；施加工作功率的10%。	MIL-STD-202 Method 103	±0.5%
工作寿命	条件D，稳态环境温度125℃，额定功率。	MIL-STD-202 Method 108	±0.5%
可焊性	245℃±5℃,5s±0.5s	MIL-STD-202 Method 208H	新锡覆盖率≥95%
耐焊接热	260℃±5℃，10s±1s	MIL-STD-202 Method 210	±0.5%
短时过负荷	5×额定功率 持续 5 s	MIL-STD-202 Method 301	±0.5%

包装与存储

散装。

订货信息

项目	代码及说明
型号	SBH
材料	M：锰铜；K：卡玛合金
阻值	R001
精度	J: ±5%; G: ±2%; F: ±1%; D: ±0.5%

标准测试条件：20±2℃，湿度65±5%；无判定疑义时，可在5~35℃、湿度45~85%下测试。